

中信证券股份有限公司
关于西安奕斯伟材料科技股份有限公司
2025 年度持续督导跟踪报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称“西安奕材”或“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。

一、持续督导工作概述

1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场检查的工作要求。

2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。

3、本持续督导期间，保荐代表人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展持续督导工作，并于 2026 年 4 月 21 日对公司进行了现场检查。

4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导职责，具体内容包括：

（1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料；

（2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司 2025 年度内部控制评价报告、会计师 2025 年度内部控制审计报告等文件；

（3）查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关内部审议文件、信息披露文件，查阅会计师出具的 2025 年度审计报告、关于西安奕斯伟材料科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明；

(4) 查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账、会计师出具的西安奕斯伟材料科技股份有限公司募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告；

(5) 对公司高级管理人员进行访谈；

(6) 对公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行公开信息查询；

(7) 查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况；

(8) 通过公开网络检索、舆情监控等方式关注与发行人相关的媒体报道情况。

二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现公司存在重大问题。

三、重大风险事项

本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

(一) 尚未盈利的风险

2025 年全球硅片出货面积同比增长，但先进制程细分市场的需求向硅片环节传导不足，汽车、工业及消费电子等传统应用的整体供需关系尚未显著改善，国内 12 英寸硅片竞争加剧，产品价格阶段性承压。同时，公司第二工厂正处于产能爬坡阶段，固定资产折旧等固定成本未能实现有效摊薄；加之公司为保障核心竞争力，持续维持较高强度的研发投入；此外，公司受到客户产能释放节奏、产品认证周期等因素影响，产品结构尚需进一步优化。多重因素共同导致报告期内公司尚未盈利。

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

公司正在进行产能扩产，若在后续扩产过程中，出现宏观环境持续恶化、半导体行业增长趋势不及预期、国际贸易摩擦加剧、地缘政治影响扩大等不利因素，

将影响公司产能扩产、客户开拓等战略计划，存在未来利润不及预期的风险。

（三）核心竞争力风险

全球 12 英寸硅片绝大部分出货量仍来自全球前五大厂商，寡头垄断格局已持续多年。与国际头部同业相比，公司在产能规模、下游产品制程先进性等方面仍存在一定差距。同时，国际头部同业对硅晶体的基础理论研究、晶体生长和硅片加工具有深厚的技术底蕴，具有技术先发优势。

公司持续提升产能规模，夯实国内第一地位，积极服务全球客户，持续进行资本性投入和研发投入。若公司研发进度不及预期，不能紧跟客户产品的更新迭代，不能如期提升产能规模及市场占有率，可能导致公司市场竞争力下降，影响公司市场地位及经营业绩。

（四）经营风险

1、毛利率水平尚需提升的风险

2025 年考虑存货跌价准备转销等因素后，公司主营业务毛利率为 3.44%。公司处于产能爬坡和产品结构逐步优化阶段，重资产模式产业在产能爬坡阶段单位固定成本较高，较高的固定成本折旧及摊销导致公司毛利率水平尚需提升。如果未来半导体行业复苏不及预期、公司客户开拓能力不足，或者公司未能如期扩产、有效控制产品成本，可能导致公司毛利率提升不及预期。

2、公司研发不能紧跟半导体工艺制程演进和客户技术迭代的风险

目前全球最先进的 2nm 逻辑芯片、1 γ 际代 DRAM 和 2YY 层堆叠结构 NAND Flash 均实现量产。遵循“一代技术、一代工艺、一代材料”的规律，下游技术迭代对 12 英寸硅片的晶体缺陷控制水平、低翘曲度、超平坦度、超清洁度和外延膜层形貌与电学性能的要求愈发苛刻。对于同一代工艺制程不同客户技术路线和指标各有差异，公司需紧跟行业技术路线和客户要求研发相匹配产品，并且持续优化工艺降本增效。此外，公司目前量产品主要为 P 型硅片，随着越来越多功率器件由 8 英寸硅片转向 12 英寸硅片，公司对应的 N 型硅片也需进一步加快研发进度及扩大客户导入。若公司研发不能及时满足客户工艺制程演进，不能紧跟客户产品的更新迭代，无法如期提升全球战略级晶圆厂客户供应量，未来经营业

绩将受到不利影响。

3、供应链风险

公司采购的部分原材料和生产设备来自日本、韩国、美国等国家厂商，前述国家或地区的政治经济环境对公司的进口采购有一定影响。公司正积极与供应链上游厂商共同研发原材料、设备等，提升采购二元化或国产化比例，以降低供应链风险。若上述国家或地区提高关税、设置更严格的出口限制条件或其他贸易壁垒，且公司与上游厂商共同研发的进度不及预期，将延缓公司后续扩产进度、降低公司生产效率。

（五）财务风险

1、汇率风险

截至 2025 年 12 月 31 日，公司境外资产账面价值为 145.00 万元，占公司资产总额的 0.01%，公司境内子公司因向境外采购设备和主材形成的应付款约 39,524.78 万元，2025 年度公司向境外销售占公司销售总额约为 25.51%。若未来汇率产生重大波动，对公司的经营业绩和资产负债将造成一定的影响。

2、利率风险

截至 2025 年 12 月 31 日，公司的有息债务合计共 645,944.47 万元，主要系公司为配合产能扩张及日常运营而持续借入的固定资产贷款及流动资金贷款。若未来国际及国内的货币政策发生重大变化，进而影响贷款市场报价利率，公司可能存在利率水平发生较大波动的风险。

3、存货减值风险

截至 2025 年 12 月 31 日，公司存货总额为 153,726.13 万元，存货跌价准备金额为 17,525.86 万元，占比为 11.40%，存货跌价准备计提、转销及转回对当期利润表影响金额为 891.49 万元。随着公司业务规模的快速增长，存货的绝对金额将随之上升。若公司未来下游客户需求、市场竞争格局发生变化，或者公司不能如期推进客户认证进度，可能导致存货无法顺利实现销售，从而使公司存在增加计提存货跌价准备的风险。

（六）行业风险

2025 年，国内半导体硅片行业在持续的政策引导与资本投入下，已进入产能快速释放与结构升级并行的新阶段。市场竞争正从单一的规模扩张，转向技术能力、客户协同与供应链稳定性的综合较量。公司虽具备一定的主场优势和本土服务经验，但随着国际龙头企业的加速布局、国内新产能的陆续投产，市场竞争维度日益多元。若公司无法持续迭代先进技术、深化客户合作及降本增效，将会影响公司的国内市场头部企业地位。

（七）宏观环境风险

1、全球经济与市场需求波动风险

半导体硅片行业的发展与宏观经济形势紧密相连，如果全球经济增长放缓或衰退可能影响消费电子、汽车电子、工业控制等主要应用领域的市场需求，可能导致硅片订单减少、价格承压、库存水位上升，将可能对公司经营业绩造成一定影响。

2、地缘政治风险

半导体行业日益成为各国战略竞争的焦点，部分国家及地区实施的出口管制、技术限制及本土化生产政策，加剧了全球供应链的不稳定性，并对关键设备、原材料及技术的跨境流动构成制约。公司将持续强化供应链韧性，并密切关注国际产业政策动向，以应对相关风险。

四、重大违规事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现公司存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2025 年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：万元

主要会计数据	2025 年	2024 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	264,922.46	212,145.26	24.88
扣除与主营业务无关的	263,607.46	211,087.28	24.88

业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入			
利润总额	-73,816.97	-73,764.25	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-73,817.08	-73,764.25	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-80,933.75	-76,255.09	不适用
经营活动产生的现金流量净额	40,469.57	81,547.82	-50.37
主要会计数据	2025 年末	2024 年末	本期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	1,241,705.57	851,481.36	45.83
总资产	2,069,812.89	1,742,196.67	18.80
主要财务指标	2025 年	2024 年	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元 / 股)	-0.21	-0.21	不适用
稀释每股收益 (元 / 股)	-0.21	-0.21	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.23	-0.22	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	-8.24	-8.32	增加0.08个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-9.03	-8.60	减少0.43个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	10.76	12.20	减少1.44个百分点

公司报告期内经营活动产生的现金净流入较上年同期减少 41,078.25 万元，主要由于报告期内收到的税费返还减少所致。

公司报告期末归属于上市公司股东的净资产较报告期初增长 45.83%，主要系报告期内收到上市募集资金，股本及资本公积增加所致

六、核心竞争力的变化情况

(一) 公司的核心竞争力

1、清晰的战略目标及高效的战略执行力，保障公司战略目标稳步实现

公司进入 12 英寸硅片领域之初就制定了 2020 至 2035 年的 15 年长期战略规划，通过建设多个核心制造基地、数个智能化工厂，致力于成为半导体硅材料领域全球头部企业。公司坚持“以终为始”的战略思维，就行业规划、技术研发、市场开拓、产能建设等多个方面提前布局。过去几年，公司严格按照 15 年长期规划稳步推进，截至报告期末，公司已实现第一阶段战略目标，正在推进第二及第三阶段战略目标实现，已布局西安和武汉两个核心制造基地，投建三座智能化工厂。其中第一工厂已经达产，第二工厂处于产能爬坡阶段，第三工厂已经启动建设，产能与出货量持续位居国内第一，全球第六，2026 年底随着第二工厂达产，将完成第二阶段“赶超者”目标。同时聚焦产品力、技术力和品质力提升，不断强化精益化管理能力，着力于将领先优势转化为健康的可持续商业回报。

2、坚持自主研发与协同创新，构建技术护城河

公司设有技术研发中心，围绕新技术、新产品及新工艺三个方面协同各工厂人员进行系统性、创新性研发活动。报告期内，公司从事研发活动相关的人员达 254 人，占员工总数比例 13.66%。各研发项目带头人均由海内外资深专家担任，具有深厚的技术背景和研发经验。公司始终坚持自主技术研发，高度重视知识产权布局与保护。在进入该领域之初即对全球前五大厂商近 20 年的半导体硅片专利全面检讨，制定并实施差异化技术路线。目前，公司已形成拉晶、成型、抛光、清洗和外延五大工艺环节的核心技术体系，产品的晶体缺陷控制水平、低翘曲度、超平坦度、超清洁度和外延膜层形貌与电学性能等核心指标已达到国内头部、全球一流水平，并取得了客户的高度认可。报告期末，公司已申请境内外专利合计 1,950 项，80%以上为发明专利；已获得授权有效专利 913 项，70%以上为发明专利，为中国大陆 12 英寸硅片领域发明专利授权数量最多的公司，其中报告期内新增申请专利 439 项，获得授权有效专利 167 项。

3、完善的品质管控体系，保障稳定量产和产品交付

公司始终秉持“以客户为中心，以品质为生命”的核心价值观，将质量管理贯穿于企业治理与可持续发展的全过程，构建了涵盖全生命周期管控与智能化运营于一体的系统化品质保障系统。团队建设方面，公司拥有多名拥有世界前五大

硅片厂 20 年以上品质管理经验的外籍技术专家，深度赋能各业务环节，为品质管理提供国际视野与顶尖技术支撑。体系架构层面，公司及子公司全面通过 ISO9001 及 IATF16949 认证，建立起覆盖市场需求识别、新品开发、生产制造、产品交付及客户服务等全流程的质量文件体系，确保各项业务高度标准化与可追溯，切实提升客户满意度。

公司持续推动从原材料端到客户端的全链路品质优化。在供应端，强化与上游供应商的协同管理，促进多晶硅、石英坩埚等关键物料品质持续升级；在过程管控中，深度融合智能化技术，运用应用统计过程控制工具，确保生产过程及产品稳定，并不断推动核心指标的持续提升。

报告期内，公司成功通过三星电子的品质体系审核，并且获得多家国内外客户授予的质量奖、优秀供应商奖、最佳贡献奖及供应商表彰奖，成为多家核心客户的首选供应商；上述成果充分彰显了公司在品质管理领域的深厚专业实力，也体现了客户对公司综合实力的高度认可。

4、国内最大的产能规模，广泛的海内外客户布局

截至报告期末，公司产能已超过 85 万片/月，持续位居国内第一，预计 2026 年底产能将达到约 120 万片/月。12 英寸硅片行业技术门槛高，导入难度大，客户黏性强，具备一定体量的产能规模，既是导入战略级头部客户、深化战略合作的先决条件，也是保障上游电子级多晶硅等关键原材料稳定供应的基础，更是公司形成规模效应、推动技术及品质迭代、支撑长远战略发展的核心保障。公司将保持战略定力和执行力，专注于 12 英寸硅片产业，持续巩固并扩大产能优势。

凭借优异的产品品质与稳定的供应能力，公司立足国内，更放眼全球，已构建起覆盖海内外主流晶圆厂商的客户体系。目前，公司系国内头部存储芯片厂商全球 12 英寸硅片厂商中供货量第一或第二大的供应商、国内头部晶圆代工厂中国大陆 12 英寸硅片供应商中供货量第一或第二大的供应商。公司在立足国内市场的同时，持续服务全球客户，包括向台积电、三星电子、美光科技、东芝、铠侠、格罗方德、力积电、联华电子、华邦、南亚科等稳定批量供货并不断进行新产品验证。

为高效响应市场需求，公司就近在海内外客户所在地建立了客户服务平台，通过与全球领先晶圆制造企业的长期合作，精准把握前沿技术趋势与客户需求变化，反向驱动技术迭代和产能扩张。

5、集中优势资源深耕 12 英寸硅片领域，聚焦行业主流方向

硅片是芯片制造的“地基”，硅片的性能和供应能力直接影响半导体产业链的竞争力。12 英寸硅片已成为市场主流。据 SEMI 预测，12 英寸硅片约贡献了 2025 年全球所有规格硅片出货面积的 78.8%。公司专注于 12 英寸硅片领域，这种垂直领域深耕的战略选择，在当前半导体材料产业竞争格局下具有资源集中的优势：

（1）市场竞争优势

12 英寸硅片属于资本密集型行业，当前下游晶圆厂扩产需求以 12 英寸为主，作为晶圆制造的核心材料，聚焦发展策略可将资源集中投入核心产线建设，并直接对接主流需求，精准匹配下游主流市场需求，快速形成规模化产销能力，有效提升运营效率与整体效益。

（2）技术深度优势

12 英寸硅片技术壁垒高，对晶体缺陷控制、表面平整度、洁净度等指标要求非常苛刻，“聚焦式研发”有助于公司形成扎实的技术积累，同时能够快速响应客户需求，保持技术与产品的领先性。

（3）规模及成本领先优势

截至报告期末，公司产能已超过 85 万片/月，持续位居 12 英寸硅片领域国内第一，大规模生产有助于产品单片固定成本持续降低、原材料采购议价能力提升、产品良率提升及品质持续迭代，同时单一尺寸为公司在“设备-材料-工艺”的供应链垂直协同创造了有利条件。

（二）核心竞争力变化情况

本持续督导期间，保荐人通过查阅同行业上市公司及市场信息，查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈等，未

发现公司的核心竞争力发生重大不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出变化

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	28,515.26	25,882.00	10.17
资本化研发投入	-	-	不适用
研发投入合计	28,515.26	25,882.00	10.17
研发投入总额占营业收入比例 (%)	10.76	12.20	减少 1.44 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	不适用	不适用	不适用

公司报告期内研发费用较上年同期增加 2,633.26 万元，增幅为 10.17%，报告期内公司持续加大研发投入推动公司产品的技术升级和创新。

（二）研发进展

截止报告期末，公司正在从事的主要研发项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	外延轻掺片开发项目	6,799.22	2,520.96	3,041.49	客户送样/小批量	满足客户需求	满足客户需求	逻辑应用领域
2	CIS 用重掺片开发项目	13,546.88	2,677.51	10,660.68	客户送样/小批量	满足客户需求	满足客户需求	图像传感器应用
3	抛光片产品结构优化项目	5,989.17	2,761.70	3,590.03	客户送样/小批量	满足客户需求	满足客户需求	存储领域
4	NAND 用抛光片产品开发项目	3,738.33	744.77	3,425.90	客户送样/小批量	满足客户需求	满足客户需求	存储领域
5	N 型单	1,561.32	780.65	855.09	样品开	满足客	满足客	新能源

	晶技术开发项目				发/客户送样	户需求	户需求	汽车、光伏及消费类产品
6	拉晶炉控制优化技术项目	1,760.97	530.29	1,687.57	样品开发	探索性研究	探索性研究	消费类产品
7	掺磷N型重掺产品开发	1,440.94	611.39	691.77	样品开发	满足客户需求	满足客户需求	功率器件和工业领域
8	PHR 产品技术开发	1,463.76	622.91	1,185.68	小批量生产	满足客户需求	满足客户需求	通讯领域
合计	/	36,300.60	11,250.17	25,138.20	/	/	/	/

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

本持续督导期间，保荐人通过查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈，基于前述核查程序，保荐人未发现公司存在新增业务。

九、募集资金的使用情况及是否合规

本持续督导期间，保荐人查阅了公司募集资金管理使用制度、募集资金专户银行对账单和募集资金使用明细账，并对大额募集资金支付进行凭证抽查，查阅募集资金使用信息披露文件和决策程序文件，实地查看募集资金投资项目现场，了解项目建设进度及资金使用进度，取得上市公司出具的募集资金存放与使用情况的专项报告和年审会计师出具的募集资金存放与使用情况鉴证报告，并对公司高级管理人员进行访谈。

基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期间，公司已建立募集资金管理制度并予以执行，募集资金使用已履行了必要的决策程序和信息披露程序，募集资金进度与原计划基本一致，基于前述检查未发现违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

本持续督导期间，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在股份质押、冻结及减持情况。

十一、保荐人认为应当发表意见的其他事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现应当发表意见的其他事项。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于西安奕斯伟材料科技股份有限公司 2025 年度持续督导跟踪报告》之签署页)

保荐代表人:

张欢

张 欢

陈泽

陈 泽

